

Ptfe 원형 웨이퍼 캐리어 6인치 내산알칼리성 반도체 세정 바스켓 맞춤 제작 가능

품목 번호: PL-CP207



소개

반도체 세정용으로 설계된 고순도 6인치 PTFE 원형 웨이퍼 캐리어입니다. 피라냐 및 HF 에칭 공정에 뛰어난 내산성 및 내알칼리성을 자랑합니다. 정밀 가공된 완전 맞춤 제작 가능한 바스켓은 까다로운 습식 화학 공정, 침지조 및 초음파 린싱 과정에서 기판을 안전하게 처리합니다.

자세히 알아보기

적용 분야	설명	주요 이점
RCA 세정 공정	SC-1 및 SC-2 용액을 사용하여 실리콘 웨이퍼에서 유기 잔류물, 얇은 산화물 층 및 이온 오염을 제거하는 데 사용됩니다.	우수한 내열성 및 내화학성이 가열조 침지 중 캐리어 열화를 방지합니다.
피라냐 에칭	고농도 유기물을 제거하기 위해 황산과 과산화수소 혼합액에서 웨이퍼를 핸들링합니다.	강력한 산화 환경에 대한 탁월한 내성으로 장비 수명을 보장합니다.
불산(HF) 침지	다양한 농도의 HF에서 실리콘 표면에서 희생 산화물 층 또는 자연 산화물을 제거합니다.	소재 순도가 민감한 에칭 환경에 금속 이온이 유입되는 것을 방지합니다.
CMP 후 린싱	화학적 기계적 연마 후 슬러리 입자를 제거하기 위해 세정 공정을 통해 웨이퍼를 이송합니다.	부드럽고 논스틱 표면이 입자 간섭을 방지하고 효과적인 초음파 세정을 용이하게 합니다.
태양전지 제조	텍스처링 및 인 확산 단계에서 6인치 단결정 또는 다결정 실리콘 웨이퍼를 처리합니다.	견고한 구조가 까다로운 산업 생산 라인에서 높은 처리량을 지원합니다.
포토리소그래피	용매와 특수 스트리퍼를 사용하여 포토레지스트를 현상하고 박리하는 과정에서 기판을 지지합니다.	범용 용매 호환성이 캐리어 프레임의 팽윤이나 연화를 방지합니다.
초음파 세정	고정밀 오염물 제거를 위해 초음파 또는 메가소닉스에서 섬세한 부품을 운반합니다.	구조적 강성이 웨이퍼 표면에 음향 에너지를 효율적으로 전달할 수 있게 합니다.
화합물 반도체 에칭	광전자 소자 제조를 위해 특수 화학 혼합물에서 GaAs, InP 또는 SiC 웨이퍼를 처리합니다.	맞춤형 슬롯 형상이 다양한 웨이퍼 두께와 취약한 기판 소재를 수용합니다.

매개변수	PL-CP207의 사양 세부정보
모델 식별자	PL-CP207
소재 구조	고순도 버진 PTFE (맞춤 PFA 옵션 제공 가능)
웨이퍼 크기 호환성	6인치 / 150mm 직경
형상 구성	원형 세정 바스켓 / 플라워 바스켓 타입
화학적 호환성	범용 내성 (산, 염기, 용매, 산화제)
내온도성	극저온부터 고온 공정까지 적합
맞춤 제작 기능	완전 맞춤형 치수, 슬롯 수 및 핸들 구성
표면 조도	정밀 가공, 초고연질, 비다공성
배치 용량	고객의 특정 웨이퍼 수 요구 사항에 맞춰 맞춤 설계

매개변수	PL-CP207의 사양 세부정보
제조 방식	맞춤형 CNC 가공 / 맞춤 제작